

证券代码：002185

证券简称：华天科技

公告编号：2019-013

天水华天科技股份有限公司 2018 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 2,131,112,944 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华天科技	股票代码	002185
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常文瑛	杨彩萍	
办公地址	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	甘肃省天水市秦州区赤峪路 88 号	
电话	0938-8631816	0938-8631990	
电子信箱	htcwy2000@163.com	caiping.yang@ht-tech.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主营业务情况

报告期，公司的主营业务为集成电路封装测试，目前公司集成电路封装产品主要有 DIP/SDIP、SOT、SOP、SSOP、TSSOP/ETSSOP、QFP/LQFP/TQFP、QFN/DFN、BGA/LGA、FC、MCM（MCP）、SiP、WLP、TSV、Bumping、MEMS、Fan-out 等多个系列。产品主要应用于计算机、网络通讯、消费电子及智能移动终端、物联网、工业自动化控制、汽车电子等电子整机和智能化领域。

公司为专业的集成电路封装测试代工企业，主要经营模式为根据客户要求及行业技术标准和规范，为客户提供专业的集成电路封装测试服务。报告期内，公司的经营模式未发生变化。

受半导体行业周期性波动和生产成本上升、子公司产能释放不及预期等因素影响，公司 2018 年度营业收入较上年度小幅增长，经营业绩有所下滑。

（二）公司所属行业情况

公司所属行业为集成电路行业，集成电路行业因其技术复杂，产业结构高度专业化，按加工流程分为集成电路设计、芯片制造、集成电路封装测试。公司为国内领先的集成电路封装测试企业，产业规模位列全球集成电路封测行业前十大之列。

从集成电路产业发展的历史情况来看，集成电路市场具有一定的周期性，但近几年来，随着集成电路应用领域的不断拓展和技术水平的不断提高，其与全球经济增长的联动性有所增强。

2018 年，在存储器市场的带动下，全球半导体市场保持增长。根据研究机构 Gartner 的初步统计数据，2018 年全球半导体产业规模达到 4767 亿美元，同比增长 13.4%，增速较 2017 年有所回落。受宏观经济增速放缓、下游应用领域增长乏力等因素影响，2018 年下半年以来，费城半导体指数持续疲软，全球半导体市场呈现出周期性调整。近几年来，全球半导体产业开始了势力格局的重新划分，各大跨国企业以强化产业链整合及控制能力为主要目的，展开了激烈的竞合博弈，产业竞争模式已从单项优势技术或产品向“全产业链竞争”转变。

2018 年，我国继续保持对半导体产业的强有力支持，我国集成电路产业发展速度仍领先于全球半导体产业，继续保持增长。根据中国半导体行业协会统计，2018 年我国集成电路产业销售额 6532 亿元，同比增长 20.7%，增速低于 2017 年的 24.8%。我国集成电路销售额与全球市场保持较高的同步性，从季度数据来看，二季度增速最高，达到 26.2%，四季度增速回落至 17.3%，拉低了全年增速。从集成电路芯片设计、晶圆制造、封装测试三业来看，2018 年三业各项增幅同比均有所下降，芯片设计业销售额 2519.3 亿元，同比增长 21.5%；晶圆制造业销售额 1818.2 亿元，同比增长 25.6%；封装测试业销售额 2193.9 亿元，同比增长 16.1%。

2018 年我国集成电路产业增速虽然高于全球半导体增长速度，但由于市场需求庞大，并且受国内设计技术以及制造工艺和产能的限制，我国集成电路仍然主要依赖进口，集成电路产品进出口额逆差仍在扩大。根据海关统计，2018 年我国进口集成电路 4175.7 亿块，同比

增长 10.8%，进口金额 3120.6 亿美元，同比增长 19.8%；出口集成电路 2171 亿块，同比增长 6.2%，出口金额 846.4 亿美元，同比增长 26.6%。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

单位：元

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减 调整后	2016 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入	7,121,706,261.65	7,009,887,112.79	7,009,876,085.85	1.60%	5,475,027,849.36	5,475,027,849.36
归属于上市公司股东的净利润	389,826,128.22	495,169,978.15	495,169,978.15	-21.27%	390,920,674.34	390,920,674.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	307,687,586.37	423,416,413.07	423,416,413.07	-27.33%	341,040,999.19	341,040,999.19
经营活动产生的现金流量净额	1,133,031,257.10	903,535,927.95	903,535,927.95	25.40%	862,521,250.89	862,521,250.89
基本每股收益（元/股）	0.1829	0.2324	0.2324	-21.30%	0.1834	0.1834
稀释每股收益（元/股）	0.1829	0.2324	0.2324	-21.30%	0.1834	0.1834
加权平均净资产收益率	7.07%	9.67%	9.67%	-2.60%	8.19%	8.19%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增 减 调整后	2016 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
资产总额	12,442,682,421.66	9,366,444,197.41	9,366,444,197.41	32.84%	7,677,244,075.28	7,677,244,075.28
归属于上市公司股东的净资产	5,694,557,262.53	5,346,960,275.79	5,346,960,275.79	6.50%	4,908,081,903.96	4,908,081,903.96

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据 2018 年 8 月修订的《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》规定，收到的扣缴税款手续费应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，因此，公司将 2017 年度收到的扣缴税款手续费 11,026.94 元由营业收入“其他业务收入”项目追溯调整至“其他收益”项目。

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,927,998,369.81	1,857,886,486.71	1,773,313,427.33	1,562,507,977.80
归属于上市公司股东的净利润	81,300,293.57	129,183,294.53	116,919,435.83	62,423,104.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	72,503,815.35	120,018,255.06	90,278,529.79	24,886,986.17
经营活动产生的现金流量净额	132,141,617.16	227,403,197.73	255,784,298.18	517,702,144.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	113,888	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	125,569	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
天水华天电子集团股份有限公司	境内非国有法人	25.97%	553,369,460	0	质押	57,492,009	
泰康人寿保险有限责任公司—投连—行业配置	其他	1.44%	30,650,439	0			
招商财富—招商银行—汇垠天粤 1 号专项资产管理计划	其他	1.40%	29,819,550	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.77%	16,314,740	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.75%	15,905,129	0			
平安信托有限责任公司—投资精英—淡水泉	其他	0.70%	14,884,500	0			
挪威中央银行—自有资金	境外法人	0.69%	14,680,363	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—淡水泉精选 1 期	其他	0.63%	13,391,116	0			
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	0.63%	13,376,665	0			
中国对外经济贸易信托有限公司—外贸信托—淡水泉精选 3 期私募证券投资基金	其他	0.61%	12,951,407	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）		报告期末，华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 24,658,641 股股份，占公司总股份的 1.16%；申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 21,572,546 股股份，占公司总股份的 1.01%；中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账					

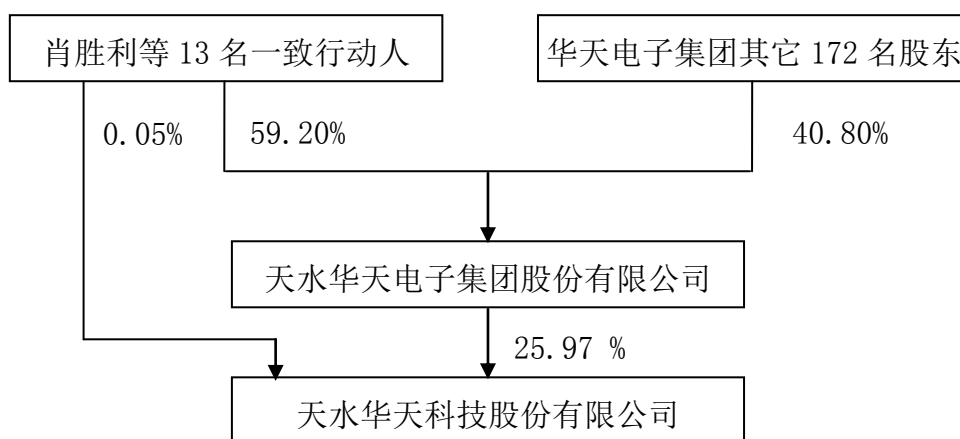
	户持有公司 17,702,169 股股份，占公司总股份的 0.83%。以股东通过各种证券账户持有公司股份的合计数重新排序后，前 10 名股东情况如上表所示。
--	--

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 概述

在 5G、大数据、人工智能、物联网等战略新兴产业发展的带动下，2018 年我国集成电路产业继续保持增长，但受宏观经济增速放缓、下游应用领域增长乏力等因素影响，2018 年集成电路产业增速较 2017 年有所回落。2018 年公司紧贴集成电路市场发展，密切关注客户需求，通过不断优化客户结构，不断进行先进封装技术研发，公司管理水平和竞争能力不断增强。

2018 年公司共完成集成电路封装量 267.24 亿只，同比下降 5.40%，晶圆级集成电路封装

量 56.40 万片，同比增长 17.51%，实现营业收入 71.22 亿元，同比增长 1.60%，营业利润 4.89 亿元，同比下降 22.31%。截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 124.43 亿元，同比增长 32.84%，归属于上市公司股东净资产 56.95 亿元，同比增长 6.50%。2018 年公司主要工作开展情况如下：

1、继续发挥销售龙头作用，努力服务好重点客户和潜力新客户。

以市场为导向，及时掌握市场动态，积极服务和维护好重点客户，确保重点客户订单稳定。同时市场开发和客户群优化工作持续开展，不断引进优质客户和具有发展潜力的客户，新开发客户八十余家，导入了存储器领域、电源类产品领域的新客户。公司及相关子公司通过了海思质量管理体系审核、产品可靠性测试或开始供货；实现继续与 FPC 合作，产品已向终端厂商小米批量供货；MPS、PI、ST、SEMTECH、PANASONIC、ROHM、IDT、MELFAS 等客户产品进入量产阶段；在与台湾地区前十大 IC 设计企业中六家合作的基础上，本年度再增加一家，达到七家。

2、持续进行先进封装技术研发，不断增强公司科技创新能力。

基于公司“硅基扇外型封装技术”，完成平面多芯片系统封装技术和 3D 硅基扇出封装技术研发，产品产业化进展顺利。FPGA+FLASH 多芯片封装实现量产，毫米波雷达芯片硅基扇外型封装产品封装良率达到 98%以上，目前已进入小批量生产阶段。三维 FAN-OUT 技术产品完成工艺验证，车载图像传感器芯片封装产品通过可靠性评估。晶圆级凸点技术实现了 16/14 纳米节点芯片的规模化量产，技术水平达到国内领先。完成 3D NAND 8 层封装技术、XWFN 封装技术、汽车电子的可润湿侧翼 QFN 技术、F-BAR 滤波器封装技术的开发，产品已进入小批量生产阶段。开发了光学指纹、QFN 指纹、温湿度传感器、激光雷达和图像传感器等 MEMS 产品。

本年度公司共获得国内授权专利 43 项，其中发明专利 18 项；通过省级新产品（新技术）备案/鉴定 9 项，其中国际先进 3 项。“一种具有接地环的 e/LQFP 堆叠封装件及其生产方法”获 2018 年甘肃省专利奖一等奖；“硅基扇外型封装技术”荣获首届集成电路产业技术创新战略联盟创新奖；“焊盘通孔全填充的 12 吋图像传感芯片 WLCSP 封装技术”获得江苏省科学技术三等奖。

3、先进封装业务规模进一步扩大，客户认证及审核成果显著。

Bumping、WLP 等先进封装产能规模进一步提高，具备接受批量订单的条件和能力。本年度通过了华为、苹果、三星、OPPO、VIVO、小米等终端主流公司的审核，部分产品已通过客户向以上终端客户供货。同时，扩展公司 CIS 产品应用领域，向消费类、汽车电子客户延伸，部分产品已通过认证。

4、新设立的南京、宝鸡生产基地陆续开工建设，满足公司未来战略发展需要。

完成南京先进封测产业基地、宝鸡引线框架及封装测试设备产业基地开工准备，项目全面开工并顺利推进。南京基地的开工建设，一方面使得公司在华东地区的布局更加完善，在产业格局上与天水、西安、昆山、上海等基地形成呼应，更好的服务产业链上下游企业，同

时也为公司储备了发展空间；宝鸡基地的布局，可从地域上分别满足母公司及子公司华天西安对引线框架的需求，保证原材料及产品质量安全，降低公司综合成本。

5、完成要约收购 Unisem 公司股份工作，产业布局不断完善。

作为公司外延式发展的战略举措，公司联合控股股东及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购马来西亚主板上市公司 UNISEM (M) BERHAD 股份。公司分别于 2018 年 9 月 12 日、2018 年 9 月 28 日召开第五届董事会十八次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过上述要约收购事项。2018 年 12 月 6 日对 Unisem 股东发出自愿全面要约，并于 2019 年 1 月 18 日完成交割，共收购 Unisem 股份数约 4.29 亿股，占 Unisem 流通股的 58.94%。

Unisem 公司在马来西亚霹靂州怡保、中国成都、印度尼西亚巴淡设有三个集成电路封装基地，拥有 Bumping、SiP、FC、MEMS 等先进封装技术和生产能力，封装的产品主要应用于射频及汽车电子领域，在欧美市场拥有相对较强的客户资源优势，欧美客户的收入占比在 60% 以上。本次要约收购 Unisem 公司将形成以中国大陆为中心，以美国凤凰城、马来西亚怡保、印度尼西亚巴淡为境外封测基地的分布格局，进一步完善公司全球化的产业布局，优化公司客户结构，切实推进公司国际化进程，提升公司全球市场竞争力。

6、启动配股再融资项目，为公司发展积能蓄力。

公司分别于 2018 年 10 月 19 日、2018 年 11 月 6 日召开的第五届董事会第十九次会议、2018 年第三次临时股东大会审议通过配股再融资事项，拟通过配股公开发行政券的方式向原股东配售股份，拟募集资金不超过 17 亿元。

(2) 主营业务分析

①营业收入构成

单位：元

	2018年		2017年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,121,706,261.65	100%	7,009,876,085.85	100%	1.60%
分行业					
集成电路	6,857,977,091.92	96.30%	6,886,734,479.65	98.24%	-0.42%
LED	263,729,169.73	3.70%	123,141,606.20	1.76%	114.17%
分产品					
集成电路	6,857,977,091.92	96.30%	6,886,734,479.65	98.24%	-0.42%
LED	263,729,169.73	3.70%	123,141,606.20	1.76%	114.17%
分地区					
国内销售	3,012,513,111.48	42.30%	2,652,606,157.99	37.84%	13.57%
国外销售	4,109,193,150.17	57.70%	4,357,269,927.86	62.16%	-5.69%

②营业成本构成

单位：元

分类	项目	2018年		2017年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
集成电路	营业成本	5,710,786,510.01	95.83%	5,634,405,088.01	97.90%	1.36%
LED	营业成本	248,523,843.10	4.17%	120,954,826.42	2.10%	105.47%

变动原因分析：本报告期 LED 产品产量增加，使得营业成本同步上升。

③产量、销量情况

行业分类	项目	单位	2018年	2017年	同比增减
集成电路	销售量	万只	2,691,765	2,789,595	-3.51%
	生产量	万只	2,672,430	2,824,995	-5.40%
	库存量	万只	79,049	98,384	-19.65%
集成电路	销售量	片	542,004	473,819	14.39%
	生产量	片	564,015	479,980	17.51%
	库存量	片	31,873	9,862	223.19%
LED	销售量	万只	1,351,575	364,558	270.74%
	生产量	万只	1,367,780	363,044	276.75%
	库存量	万只	55,450	39,245	41.29%

变动原因分析：主要为募集资金投资项目产能逐步释放和客户订单增加，使得集成电路封装产量较上年同期大幅增加。

(3) 下一年度经营计划

根据行业特点和市场预测，2019 年度公司生产经营目标为全年实现营业收入 85 亿元，生产经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场需求、产品价格及客户经营状况等多种因素，存在不确定性，请投资者特别注意。

2019 年主要开展以下工作：

①坚持“以客户为中心，为客户创造价值”的管理理念，加强与客户沟通交流，及时掌握市场动态，全面服务好国际客户和重点客户，确保已有客户订单稳定；同时提高技术、质量团队在市场开发中的参与度，挖掘客户需求，积极争取潜在客户和已有客户增量订单。

②在 2019 年 1 月完成要约收购 Unisem 公司股份交割工作的基础上，做好公司与 Unisem 公司在客户资源、技术、生产经营等方面的交流合作，持续提升双方在成本控制和综合运营等方面的绩效，进一步增强持续盈利能力和在国际市场的竞争力。

③推进南京先进封测产业基地、宝鸡引线框架及封装测试设备产业基地项目建设，力争 2019 年底南京先进封测产业基地厂房主体完工，具备设备安装条件，宝鸡引线框架及封装测试设备产业基地完成项目建设，具备生产条件。

(4) 未来面对的风险因素分析

①受半导体行业景气状况影响的风险

公司所处行业受半导体行业的景气状况影响较大，公司经营状况与半导体行业的景气状况紧密相关，半导体行业发展过程中的波动将使公司面临一定的行业经营风险。另外，随着集成电路封装测试行业的竞争越来越激烈，也将加大公司的经营难度。

②产品生产成本上升的风险

公司产品主要原材料价格的波动会导致公司经营业绩出现一定的波动。同时，随着近几年人力成本的持续上升，给公司的成本控制造成一定压力。

针对上述风险，公司未来将继续优化生产工艺流程，加大工艺升级力度，提高设备利用率；强化节能降耗和材料消耗管理，降低经营成本；提高生产自动化、信息化水平，增强公司的盈利能力和抗风险能力。

③技术研发与新产品开发失败的风险

集成电路市场的快速发展和电子产品的频繁更新换代，使得公司必须不断加快技术研发和新产品开发步伐，如果公司技术研发能力和开发的新产品不能够满足市场和客户的需求，公司将面临技术研发和新产品开发失败的风险。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
集成电路	6,857,977,091.92	497,084,775.60	16.73%	-0.42%	-23.70%	-1.46%
LED	263,729,169.73	-8,120,391.75	5.77%	114.17%	63.59%	3.99%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1) 与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

1、资产负债表：

- (1) 将原“应收票据”及“应收账款”项目归并至“应收票据及应收账款”；
- (2) 将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”项目归并至“其他应收款”；
- (3) 将原“固定资产”及“固定资产清理”项目归并至“固定资产”；
- (4) 将原“工程物资”及“在建工程”项目归并至“在建工程”；
- (5) 将原“应付票据”及“应付账款”项目归并至“应付票据及应付账款”；
- (6) 将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”项目归并至“其他应付款”；
- (7) 将原“长期应付款”及“专项应付款”项目归并至“长期应付款”。

2、利润表：

- (1) 将“管理费用”项目拆分“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；
- (2) 利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；
- (3) 企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。

3、所有者权益变动表：

新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3) 与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、本期新设立的子公司

(1) 本公司于 2018 年 3 月在陕西省宝鸡市设立全资子公司华天科技（宝鸡）有限公司，统一社会信用代码：91610301MA6XE5B16K，注册资本壹亿元人民币。

(2) 本公司于 2018 年 7 月在陕西省西安市设立控股子公司华天科技（西安）投资控股有限公司，统一社会信用代码：91610132MA6W14A074，注册资本伍亿元人民币。

2、本期新设立的孙公司

(1) 本公司的控股子公司华天科技（西安）投资控股有限公司于 2018 年 9 月在江苏省南京市设立子公司华天科技（南京）有限公司。

(2) 本公司的全资子公司华天科技（香港）产业发展有限公司于 2018 年 7 月在马来西亚设立全资子公司 HuatianTechnology (MALAYSIA) Sdn. Bhd. 。

(3) 本公司的境外下属子公司 FlipChipInternational, LLC 于 2018 年 4 月在美国设立全资子公司 FlipChip-AD, LLC。

(4) 对 2019 年 1-3 月经营业绩的预计

适用 不适用

天水华天科技股份有限公司

法定代表人：肖胜利

二〇一九年四月三十日